

開示の要約

リテーナリングおよび基板保持装置

- 5 基板のエッジ部を含めた基板全体の研磨プロファイルを所望のプロファイルに一致させるために基板保持装置に設けられるリテーナリングが開示される。リテーナリングは、研磨液が供給された研磨パッドに基板を押しつけて該基板を研磨するための基板保持装置に用いられる。リテーナリングは、リング形状を有し、研磨パッドに押し付けられた基板の外周を支持するリング本体を備える。リング
- 10 本体は、研磨パッドに押し付けられる下面に形成され、リング本体と同心状に延びる少なくとも1つのリング溝と、研磨液がリング本体の外部から内部に到達するのを阻害するバリアと、を有する。

図 4